

반도체장비용 오링의 기밀성시험장치

한국기계연구원

김동수 | 최병오 | 박화영

■ 권리사항

출원(등록)번호 10-0359995 | 출원(등록)일 2002년 10월

■ 적용가능분야 및 목표시장

기밀 시험 장비

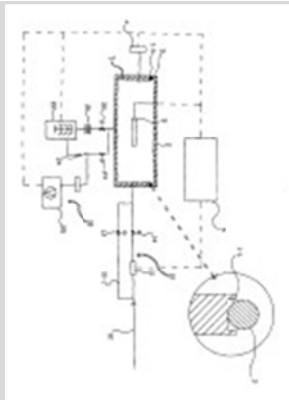
■ 기술 개요

본 기술은 반도체장비인 화학기상증착(CVD)장비, 물리기상증착(PVD)장비, 식각(Etcher) 장비 중 프 로세스 챔버의 기밀성을 유지하기 위하여 사용되는 오링에 대한 기밀성을 실제 사용환경하에서 시험하는 반도체장비용 오링의 기밀성시험장치임

■ 기술의 특징점

반도체장비용 오링의 기밀성데이터(누설량, 경도, 인장강도, 연신율, 등)에 대한 신뢰성을 향상

■ 기술 세부내용



[반도체장비용 오링의 기밀성시험장치]

시험챔버와; 유해가스공급부와; 진공형성부와; 센서와; 제어부

■ 기술완성도(TRL)

4단계(실험실 규모의 핵심성능 평가)